

Shanghai, 23-26 ottobre 2019

Fiera in Cina sul packaging per e-commerce

La manifestazione organizzata da Fiera Milano attraverso la joint-venture Hannover Milano Fairs Shanghai con Deutsche Messe.

Dopo le recenti acquisizioni di due manifestazioni fieristiche in Cina e una in Brasile, Fiera Milano prosegue nella strategia di espansione sui mercati internazionali con un salone dedicato al packaging per l'e-commerce in Cina, E-Pack Tech, che debutterà nell'ottobre dell'anno prossimo a Shanghai all'interno di CeMAT Asia (23-26 ottobre 2019), dedicata a movimentazione interna, automazione tecnologica, sistemi di trasporto e logistica.



L'evento è organizzato da Fiera Milano attraverso Hannover Milano Fairs Shanghai, società cinese in joint-venture con Deutsche Messe, in partnership con Ipack Ima Srl.

Grazie a questa nuova manifestazione - affermano gli organizzatori - le eccellenze italiane ed europee potranno avere fin da subito un contatto diretto con il mercato cinese, dando avvio ad incontri di business nel mercato locale.

Con un fatturato di 7,2 miliardi di euro nel 2017 (fonte Ucima), la costruzione di macchine automatiche per il confezionamento e l'imballaggio è uno dei comparti industriali italiani in continua crescita, e la Cina rappresenta il quinto mercato di destinazione per l'export per le aziende nazionali che producono tecnologie per packaging. L'e-commerce è oggi uno dei driver della crescita del settore: quattro aziende su dieci che producono questo tipo di macchinari hanno ricevuto richieste specifiche per il canale del commercio on-line.

© Polimerica - Riproduzione riservata